

杭州士兰微电子股份有限公司

对外投资进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、投资概述

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 8 月 26 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于投资建设士兰集昕二期项目（即“8 吋芯片生产线二期项目”）的议案》，同意公司控股子公司杭州士兰集昕微电子有限公司（以下简称“士兰集昕”）对 8 吋芯片生产线进行技术改造，形成新增年产 43.2 万片 8 英寸芯片制造能力。“8 吋芯片生产线二期项目”总投资 15 亿元，其中公司和国家集成电路产业投资基金股份有限公司以货币方式共同出资 8 亿元认购士兰集昕新增的注册资本 702,983,849 元，其余资金通过向金融机构融资解决。

公司于 2019 年 11 月 25 日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司增加注册资本的议案》，同意杭州集华投资有限公司（以下简称“集华投资”）新增注册资本 6.15 亿元，士兰集昕新增注册资本 702,983,849 元。

上述事项详见公司于 2019 年 8 月 28 日和 2019 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上披露的《关于投资建设士兰集昕二期项目的公告》（公告编号：临 2019-037）和《关于控股子公司增加注册资本的公告》（公告编号：临 2019-052）。

二、投资进展情况

集华投资和士兰集昕各股东已于近日分别完成了上述新增注册资本的全部增资款的缴纳事项，具体如下：

1、增资缴款完成后，集华投资的股权结构及实收资本情况如下所示：

股东名称	认缴注册资本 (万元)	实缴注册资本 (万元)	持股比例 (%)
杭州士兰微电子股份有限公司	52,500	52,500	51.22
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	50,000	50,000	48.78

合计	102,500	102,500	100.00
----	---------	---------	--------

2、增资缴款完成后，士兰集昕的股权结构及实收资本情况如下所示：

股东名称	认缴注册资本 (元)	实缴注册资本 (元)	持股比例 (%)
杭州士兰微电子股份有限公司	123,454,935	123,454,935	6.29
杭州士兰集成电路有限公司	72,303,290	72,303,290	3.68
杭州高新科技创业服务有限公司	263,637,338	263,637,338	13.44
杭州集华投资有限公司	927,237,887	927,237,887	47.25
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	575,745,962	575,745,962	29.34
合计	1,962,379,412	1,962,379,412	100.00

特此公告！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2020年4月30日